(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 6 月 4 日(04.06.2015)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2015/080295 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/28 (2012.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/081800

(22) 国際出願日: 2014 年 12 月 1 日(01.12.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2013-248263 2013 年 11 月 29 日(29.11.2013) JP
特願 2013-248291 2013 年 11 月 29 日(29.11.2013) JP

(71) 出願人: ＨＯＹＡ株式会社(**HOYA CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合２丁目７番５号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 玉置　将徳(**TAMAKI, Masanori**); 〒1618525 東京都新宿区中落合２丁目７番５号 ＨＯＹＡ株式会社内 Tokyo (JP). 中川　裕樹(**NAKAGAWA, Hiroki**); 〒1618525 東京都新宿区中落合２丁目７番５号　ＨＯＹＡ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: グローバル・アイピー東京特許業務法人(**GLOBAL IP TOKYO**); 〒1600023 東京都新宿区西新宿８丁目３番３０号　カーメルＩＩ Tokyo (JP).

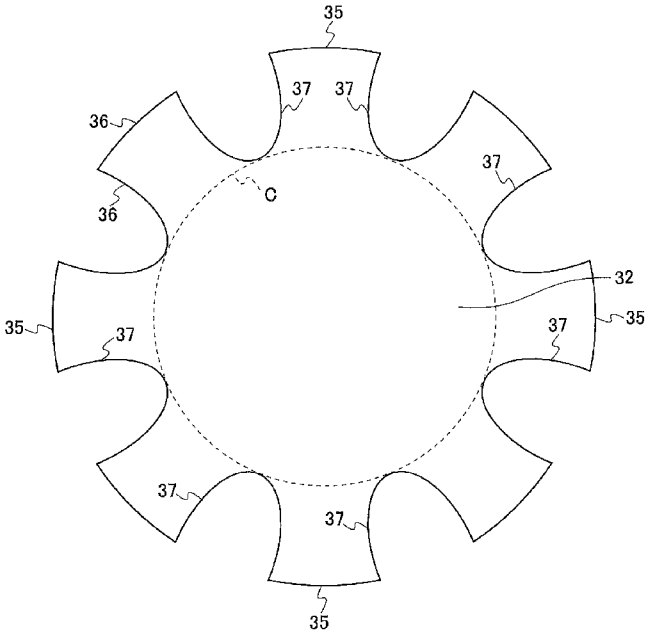
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) Title: CARRIERS FOR POLISHING, MANUFACTURING METHOD FOR CARRIERS FOR POLISHING, AND MAGNETIC DISC SUBSTRATE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称 : 研磨処理用キャリア、研磨処理用キャリアの製造方法、及び磁気ディスク用基板の製造方法



(57) Abstract: A carrier for polishing is formed from a composite material containing fibers oriented at least in one direction and resin material, and has a retaining hole for retaining a disc-shaped substrate when polishing a pair of main surfaces of the substrate by sandwiching the substrate with a top surface plate and a bottom surface plate. The retaining hole has, on the periphery of an inner circumferential wall face of the retaining hole: a first wall that is configured so that the substrate contacts the fibers in a state where the substrate is retained in the retaining hole; and a second wall that is configured so that the substrate does not contact the fibers. The second wall is formed in a portion of the inner circumferential wall face that faces in the direction, which includes the one direction, of fiber orientation.

(57) 要約: 研磨処理用キャリアは、少なくとも一方向に配向した繊維と樹脂材料とを含む複合材料から形成され、円板状の基板を上定盤及び下定盤で挟んで前記基板の一対の主表面を研磨処理する際に前記基板を保持するための保持穴を有している。前記保持穴は、前記保持穴の内周壁面の周上に、前記保持穴に前記基板が保持された状態で前記基板が前記繊維と接触するよう構成された第１の壁部と、当該基板が前記繊維と接触しないように構成された第２の壁部と、を有している。前記第２の壁部は、前記内周壁面のうち、前記一方向を含む前記繊維の配向方向を向く部分に形成されている。

WO 2015/080295 A1